

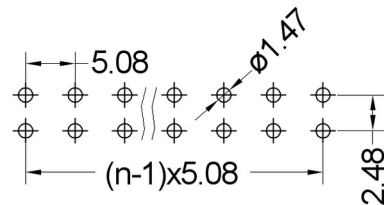
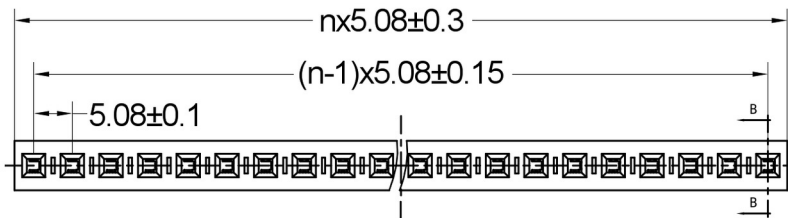
## Buchsenleisten RM 5,08mm, gerade – Power-Kontakte, Doppelfederkontakt Female Headers, 5.08mm Pitch, Straight – Double spring power contacts

### Technische Daten / Technical Data

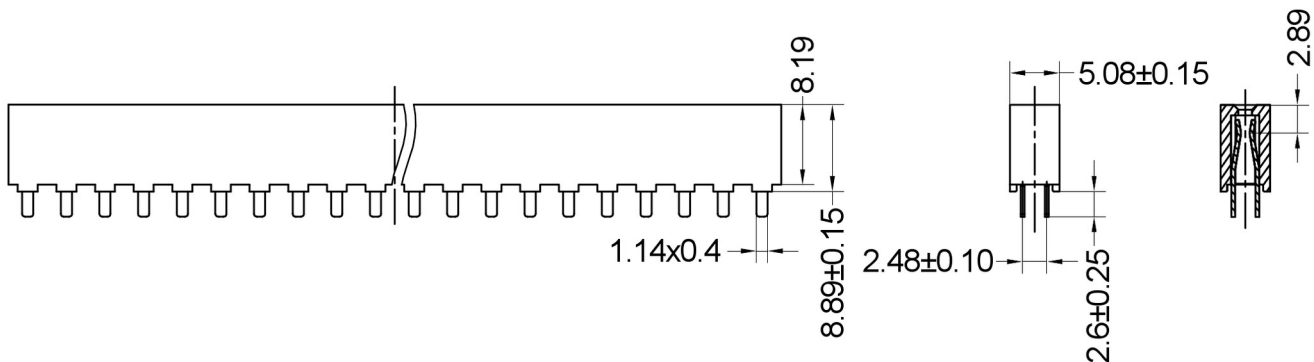
|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Isolierkörper         | Thermoplast, nach UL94 V-0                            |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                         |
| Kontaktmaterial       | Kupferlegierung                                       |
| Contact Material      | Copper alloy                                          |
| Kontaktfläche         | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni                      |
| Contact Surface       | Acc. to options (see below), over Ni                  |
| Durchgangswiderstand  | < 20 mΩ                                               |
| Contact Resistance    | < 20 mΩ                                               |
| Isolationswiderstand  | > 1000 MΩ                                             |
| Insulation Resistance | > 1000 MΩ                                             |
| Spannungsfestigkeit   | 1000 V AC/DC                                          |
| Test Voltage          | 1000 V AC/DC                                          |
| Nennstrom             | 7 A                                                   |
| Current Rating        | 7 A                                                   |
| Temperaturbereich     | -40 °C ... +105 °C                                    |
| Temperature Range     | -40 °C ... +105 °C                                    |
| Verarbeitung          | 230 °C für 30-60 Sekunden<br>(260 °C für 10 Sekunden) |
| Processing            | 230 °C for 30-60 seconds<br>(260 °C for 10 seconds)   |



Doppelfederkontakte für  
Vierkantstifte 1,14mm.  
Dual beam contacts accept  
1.14mm square pins.



Recommended PCB Layout (Top Side)  
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



### Series

**46-395**

46-395 Doppelfederkontakt  
Double spring contact

### Contacts\*

**05**

02-20 Einreihig  
Single row

### Rows

**1**

1 Einreihig  
Single row

### Plating\*

**00**

00 Vergoldet  
Gold plated  
55 Matt-Zinn  
Matted tin plated

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Reflow-Lötverfahren

### Reflow Soldering Information

#### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert                        |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150 °C                          |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200 °C                          |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60 – 180s                       |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | untere Temperaturangabe [°C]    |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s                   |
| Höchsttemperatur $T_P$               | obere Temperaturangabe [°C]     |
| Dauer Höchsttemperatur               | laut Angabe im Datenblatt [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s                        |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m                         |

#### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values              |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150 °C                  |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200 °C                  |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60 – 180s               |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | Lower Temperature [°C]  |
| Duration above $T_L$                 | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s           |
| Peak Temperature $T_P$               | Upper Temperature [°C]  |
| Duration Peak Temperature            | Acc. to datasheet [sec] |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s                |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | max. 8min               |

